

## 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料(スミコン® EME)の価格改定について

住友ベークライト株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鍛冶屋 伸一)は、このたび半導体封止用エポキシ樹脂成形材料(以下、スミコン® EME)の販売価格を改定することをお知らせいたします。

昨今の中東情勢を起因として、スミコン® EME に使用する原材料の調達コストが上昇しております。あわせて、梱包資材、エネルギー費、輸送費等の各種コストも高騰が続いており、製品コスト全体を押し上げる要因となっております。

当社では、お客様への安定供給を果たすため、原料確保と生産継続を最優先として対応に当たっておりますが、これら価格高騰の影響は当社の自助努力で吸収できる範囲を超えており、現行価格を維持することが極めて困難な状況となりました。つきましては、下記のとおり製品価格の改定を顧客に申し入れることといたしました。

## 記

## 1. 価格改定対象製品

・半導体封止用エポキシ樹脂成形材料 スミコン® EME(全品目)

## 2. 価格改定幅

現行価格の約10%~20%アップ

## 3. 価格改定時期

2026年6月1日出荷分より

なお、今後、原材料、副資材、物流費等の各種コストに大きな変動が生じた場合には、改訂内容を見直す場合があります。

## 【本件に関するお問い合わせ先】

住友ベークライト株式会社 情報通信材料営業本部

Tel:03-5462-4264

お問い合わせフォーム [https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j\\_itmaterials\\_epoxy](https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_itmaterials_epoxy)